

概要

この通知は、一部のプラスチック ボール グリッド アレイ FG(G) および BG(G) パッケージにおけるマーキング テンプレートとトレイのマイナー チェンジをお知らせするものです。この変更は、プラスチック ボール グリッド アレイを採用しているザイリンクスの XC コマーシャル (C) および (I) グレード FPGA デバイスがピン ゲート モールド (PGM) へ移行されることに伴うものです ([XCN12023](#) 参照)。この通知は、オートモーティブ (XA) および HiRel (XQ) FPGA 製品に該当します。

説明

アセンブリ サプライヤーは、該当する XC コマーシャル (C) および (I) グレード FPGA デバイスの FG(G) および BG(G) パッケージにおいてコーナー ゲート モールドからピン ゲート モールドへの移行を進めています ([XCN12023](#) 参照)。ザイリンクスのオートモーティブ (XA) および HiRel (XQ) FPGA 製品にピン ゲートへの移行が実施されるわけではありませんが、パッケージのトップ マーキング テンプレートおよびトレイに若干の変更が必要となります。

1. マーキング テンプレートのマイナー変更 : CGM のイジェクター ピンは図 1 のピン 1 が示す位置のまま変わりませんが、PGM のイジェクター ピンはパッケージの中央に移動します。PGM および CGM における新しいマーキング テンプレートは、BG(G)256、FG(G)320、FG(G)400、FG(G)456、FG(G)484 および FG(G)676 FPGA デバイス パッケージすべてに適用される予定です ([図 1](#) 参照)。
2. 出荷トレイ : 23mm x 23mm PBGA パッケージの出荷トレイが変更されます。Daewon 社製の新しい 23mm x 23mm PBGA トレイマトリクスは、現在の出荷トレイと互換性があり、トレイの X/Y 寸が一致します。ただし、この新しい Daewon 社製 23mm x 23mm トレイには滑り止めが付いているため、現在のトレイに積み重ねることはできません。新しいトレイには、セル キャビティの底面に大きなキャビティ ポケットが設けられています。これは、より大きな CGM モールド本体に合せて設計されています。新しい Daewon 社製トレイと現在の出荷トレイを重ねたり、混ぜて使用したりしないことを推奨します。詳細は、[表 2](#) および [図 2](#) を参照してください。

この変更による、フォーム、形状、機能、信頼性への影響はありません。

該当製品

新しいマーキング テンプレートおよびトレイが採用される該当製品には、オートモーティブ (XA) および HiRel (XQ) FPGA のすべての標準とそれらの SCD (Specification Control Document) 製品が含まれます。[表 1](#) に、該当製品番号を示します。

XA/QX デバイス向け FG(G) および BG(G) ワイヤ ボンド パッケージの
マーキング テンプレートとトレイの変更

表 1: 新しい CGM マーキング テンプレートを採用した該当 FPGA デバイス ファミリ

デバイス	パッケージ	デバイス	パッケージ	デバイス	パッケージ	デバイス	パッケージ
XQV100	BG(G)256	XA3S400	FG(G)456	XA6SLX45	FG(G)484	XA3S1500	FG(G)676
XA3S1200E	FG(G)400	XQ2V1000 *	FG(G)456	XA6SLX45T	FG(G)484	XA3SD1800A	FG(G)676
XA3S1600E	FG(G)400	XA3S1400A	FG(G)484	XA6SLX75	FG(G)484	XA3SD3400A	FG(G)676
XA3S400A	FG(G)400	XA3S1600E	FG(G)484	XA6SLX75T	FG(G)484	XQ2VP40	FG(G)676
XA3S700A	FG(G)400	XA3S700A	FG(G)484	XQ6SLX150	FG(G)484	XQ6SLX150T	FG(G)676
XADAISY	FG(G)400	XA6SLX100	FG(G)484	XQ6SLX150T	FG(G)484	XQ6SLX75T	FG(G)676
XA3S1000	FG(G)456	XA6SLX25	FG(G)484	XQ6SLX75	FG(G)484		
XA3S1500	FG(G)456	XA6SLX25T	FG(G)484	XQ6SLX75T	FG(G)484		

* [XCN12026](#) PDN に該当するデバイスです。

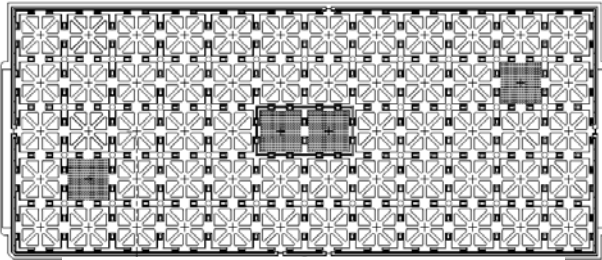
PGM および CGM の新しいマーキング テンプレートの例を次に示します。



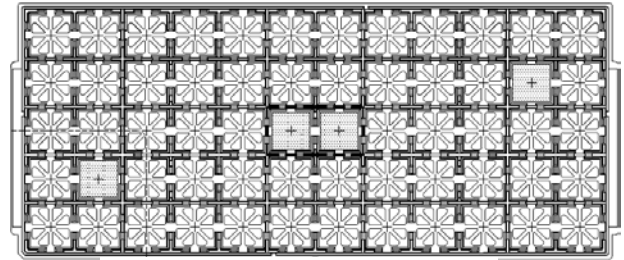
図 1: マーキング テンプレート

表 2: トレイ情報

トレイ タイプ	現在のトレイ		新規トレイ	
	Daewon 社のトレイ 製品番号	ザイリンクス 図面番号	Daewon 社のトレイ 製品番号	ザイリンクス 図面番号
23 x 23mm パッケージ用 JEDEC L/P PBGA トレイ (60 ポケット)	1F1-2323-919 Rev. A	SIT0089	T0812012 Rev. B	SIT0148



現在のトレイ : 1F1-2323-919 Rev.A
ベンダー : Daewon



新規トレイ : T0812012 Rev.B
ベンダー : Daewon

図 2 : トレイ詳細図

キーデータおよび注文情報

ザイリンクスは、新しいマーキング テンプレートを採用した PGM および CGM パッケージの混合出荷を 2014 年 2 月 1 日までに開始します。

お問い合わせ

この通知に対する回答は必要ありません。その他ご不明な点、ご質問等ございましたら、[ザイリンクステクニカル サポート](#)までお問い合わせください。

重要なお知らせ :ザイリンクス カスタマー通知 (XCN, XDN, Quality Alert) リリースの通知は、サポートウェブサイト (<http://japan.xilinx.com/support>) から e-mail で受け取ることができます。アカウントご登録後、資料とデザイン アドバイザリ アラートにカスタマー 変更通知が含まれるようにカスタマイズしてください。ザイリンクス サポート サイトでは、指定された製品に関する新規および更新情報、データシートやエラッタ、アプリケーション ノートなどに関するアラートを受け取ることができるサービスを提供しています。登録方法は、ザイリンクス アンサー 18683 (<http://japan.xilinx.com/support/answers/18683.htm>) を参照してください。

改訂履歴

次の表に、この文書の改訂履歴を示します。

日付	バージョン	内容
2012 年 12 月 17 日	1.0	初版リリース

Notice of Disclaimer

The information disclosed to you hereunder (the “Materials”) is provided solely for the selection and use of Xilinx products. To the maximum extent permitted by applicable law: (1) Materials are made available “AS IS” and with all faults, Xilinx hereby DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE; and (2) Xilinx shall not be liable (whether in contract or tort, including negligence, or under any other theory of liability) for any loss or damage of any kind or nature related to, arising under, or in connection with, the Materials (including your use of the Materials), including for any direct, indirect, special, incidental, or consequential loss or damage (including loss of data, profits, goodwill, or any type of loss or damage suffered as a result of any action brought by a third party) even if such damage or loss was reasonably foreseeable or Xilinx had been advised of the possibility of the same. Xilinx assumes no obligation to correct any errors contained in the Materials, or to advise you of any corrections or update. You may not reproduce, modify, distribute, or publicly display the Materials without prior written consent. Certain products are subject to the terms and conditions of the Limited Warranties which can be viewed at <http://www.xilinx.com/warranty.htm>; IP cores may be subject to warranty and support terms contained in a license issued to you by Xilinx. Xilinx products are not designed or intended to be fail-safe or for use in any application requiring fail-safe performance; you assume sole risk and liability for use of Xilinx products in Critical Applications: <http://www.xilinx.com/warranty.htm#critapps>.

この通知は参照用として、英語版 (XCEN12024、バージョン 1.0、2012 年 12 月 17 日発行) を翻訳したものです。